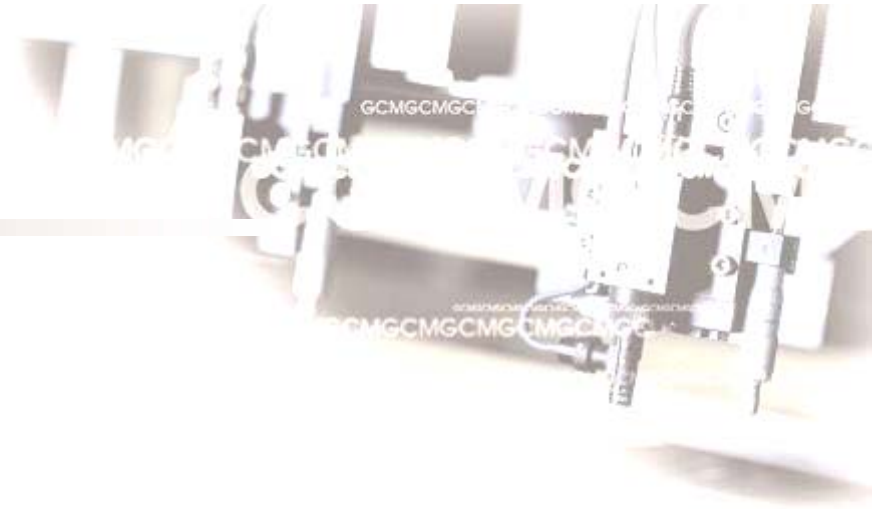


2011年2月期決算説明会資料

2011年4月19日
RORZE CORPORATION



2011年2月期 決算概要

2011年2月期 連結損益計算書

(百万円)

	2010年2月期 実績	2011年2月期 実績	増減率	増減理由等
売上高	3,610	10,990	204.4%	【増加要因】 ・半導体や液晶関連の設備投資が回復し、国内の他、 韓国ガラス基板搬送装置・ガラスカッティングマシン 台湾のウエハ搬送装置を中心に、欧米・シンガポール 等においても受注が好調に推移
売上総利益	327	2,929	794.5%	【増加要因】 ・当社、並びに韓国、台湾子会社を中心とした大幅な 増収 ・上記に伴うベトナム生産子会社の生産性の向上 等
販管費	1,442	1,769	22.7%	【増加要因】 ・売上増加に伴う人件費、販売関連費用の他、 各種経費の増加 ・開発研究強化に伴う費用増加 等
営業利益又は 営業損失(△)	△1,115	1,159	—%	
経常利益又は 経常損失(△)	△953	1,041	—%	(営業外損益の増減につきましては、決算短信を ご参照下さい)
当期純利益又は 当期純損失(△)	△663	613	—%	(特別損益の増減につきましては、決算短信を ご参照下さい)

2011年2月期 連結貸借対照表

(百万円)

	2010年2月期実績	2011年2月期実績	増減額	増減理由等
流動資産	7,666	9,202	1,536	・現金及び預金 $\Delta 384$ ・受取手形及び売掛金 $+1,004$ ・たな卸資産 $+787$
固定資産等	6,806	6,368	$\Delta 437$	・建物及び構築物 $\Delta 269$ ・機械装置 $\Delta 75$ ・その他(有形固定資産) $+99$ ・投資有価証券 $\Delta 82$ ・繰延税金資産 $\Delta 69$
資産合計	14,472	15,571	1,098	
流動負債	5,158	5,588	430	・支払手形及び買掛金 $+525$ ・短期借入金 $\Delta 488$ ・未払法人税等 $+51$ ・繰延税金負債 $+83$ ・製品保証引当金 $+139$
固定負債	2,112	2,416	304	・長期借入金 $+298$
負債合計	7,270	8,005	734	
株主資本	7,336	7,950	613	・利益剰余金 $+613$
評価・換算差額等	$\Delta 1,125$	$\Delta 1,464$	$\Delta 339$	・為替換算調整勘定 $\Delta 328$
新株予約権	11	27	16	
少数株主持分	979	1,052	73	・少数株主持分(主に韓国子会社) $+73$
純資産合計	7,202	7,566	364	
負債純資産合計	14,472	15,571	1,098	

2011年2月期 連結キャッシュ・フロー

(百万円)

	2010年2月期 実績	2011年2月期 実績	増減額
営業活動による キャッシュ・フロー	387	232	△155
投資活動による キャッシュ・フロー	4	△324	△328
財務活動による キャッシュ・フロー	△551	△184	367
現金及び現金同等物 に係る換算差額	62	△69	△131
現金及び現金同等物 の減少額	△96	△345	△248
現金及び現金同等物 の期首残高	2,359	2,262	△96
現金及び現金同等物 の期末残高	2,262	1,917	△345

2011年2月期 個別損益計算書

(百万円)

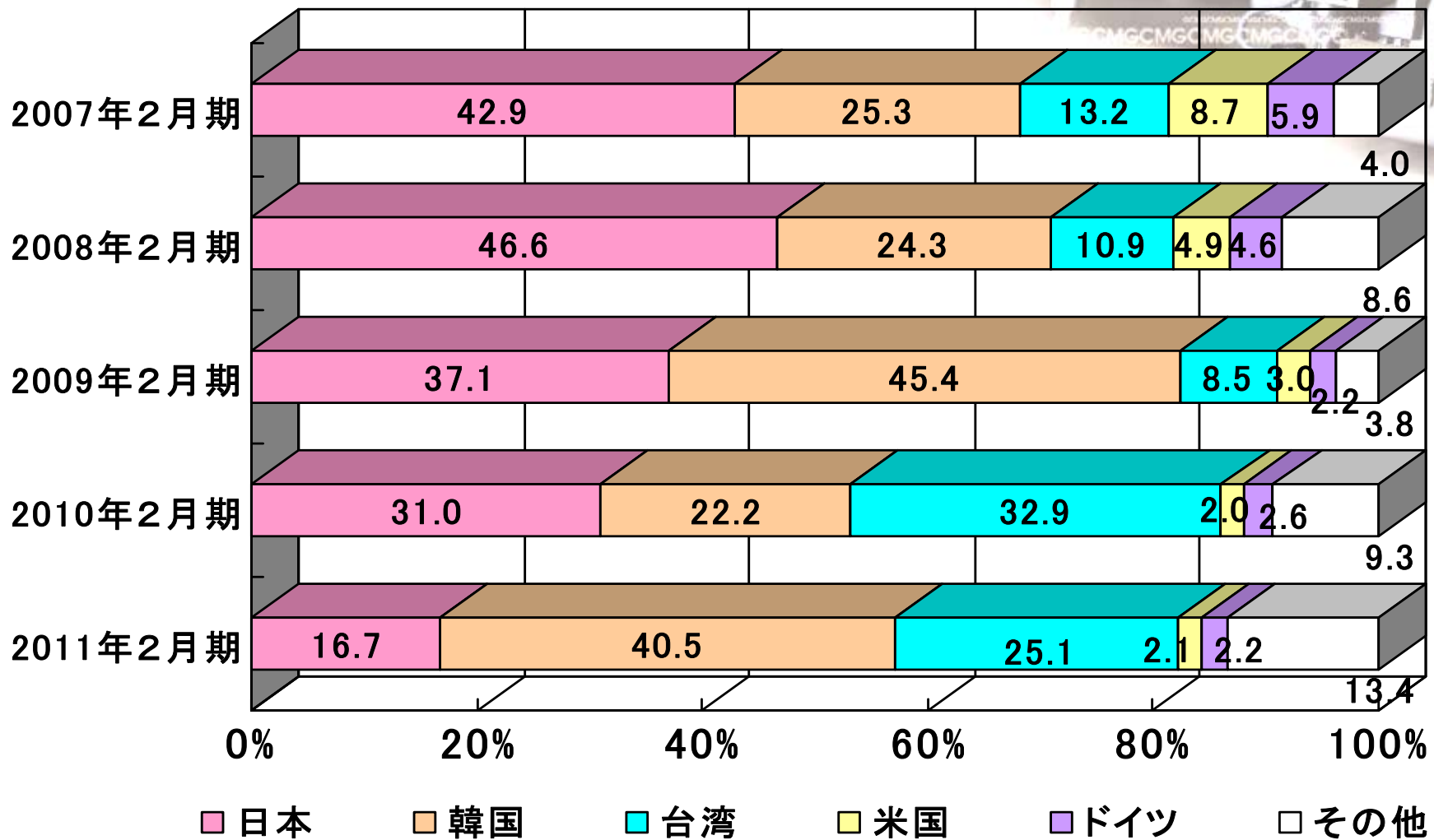
	2010年2月期 実績	2011年2月期 実績	増減率	増減理由等
売上高	2,163	4,942	128.5%	【増加要因】 ・国内外の半導体設備投資の回復による受注増加
売上総利益	55	911	1,531.7%	【増加要因】 ・売上の大幅な増加
販管費	733	882	20.3%	【増加要因】 ・売上増加に伴う人件費、販売関連費用の他、各種経費の増加
営業利益又は 営業損失(△)	△677	29	—%	
経常利益又は 経常損失(△)	△574	36	—%	(営業外損益の増減につきましては、決算短信をご参照下さい)
当期純利益又は 当期純損失(△)	△370	22	—%	(特別損益の増減につきましては、決算短信をご参照下さい)

2011年2月期 個別貸借対照表

(百万円)

	2010年2月期実績	2011年2月期実績	増減額	増減理由等
流動資産	4,940	4,834	△106	<ul style="list-style-type: none"> ・現金及び預金 △877 ・受取手形及び売掛金 +592 ・たな卸資産 +175
固定資産	8,125	8,244	119	<ul style="list-style-type: none"> ・建物 △73 ・工具、器具及び備品 +80 ・ソフトウェア +73 ・関係会社長期貸付金 +115 ・繰延税金資産 △69
資産合計	13,066	13,079	13	
流動負債	4,405	4,077	△327	<ul style="list-style-type: none"> ・支払手形 +218 ・買掛金 △72 ・短期借入金 △350 ・未払金 △123
固定負債	1,970	2,281	310	<ul style="list-style-type: none"> ・長期借入金 +298
負債合計	6,376	6,359	△16	
株主資本	6,634	6,657	22	<ul style="list-style-type: none"> ・別途積立金 △350
評価・換算差額等	44	34	△9	<ul style="list-style-type: none"> ・繰越利益剰余金 +372
新株予約権	11	27	16	
純資産合計	6,690	6,720	29	
負債純資産合計	13,066	13,079	13	

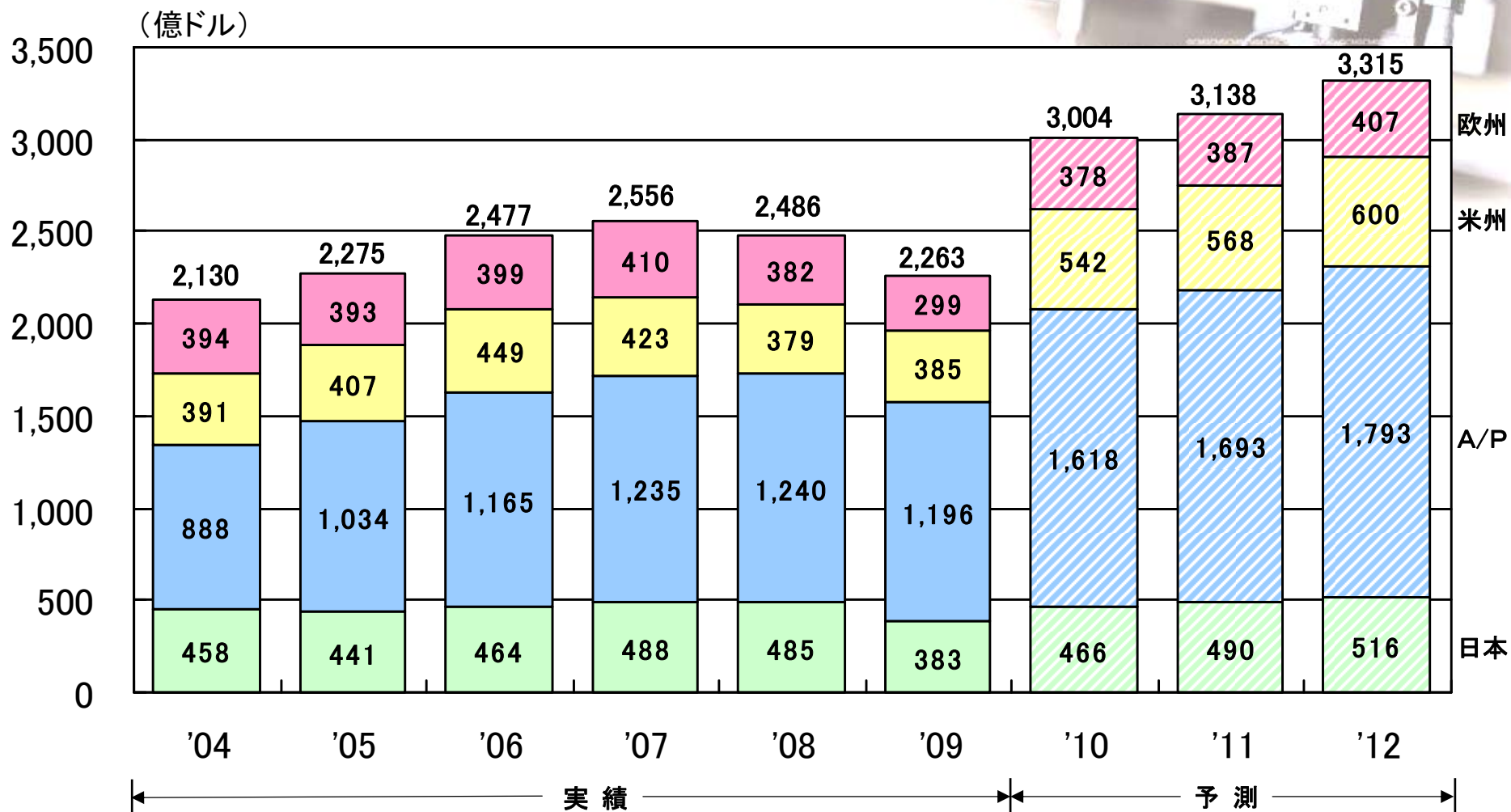
海外売上高(連結)





2012年2月期 業績予想

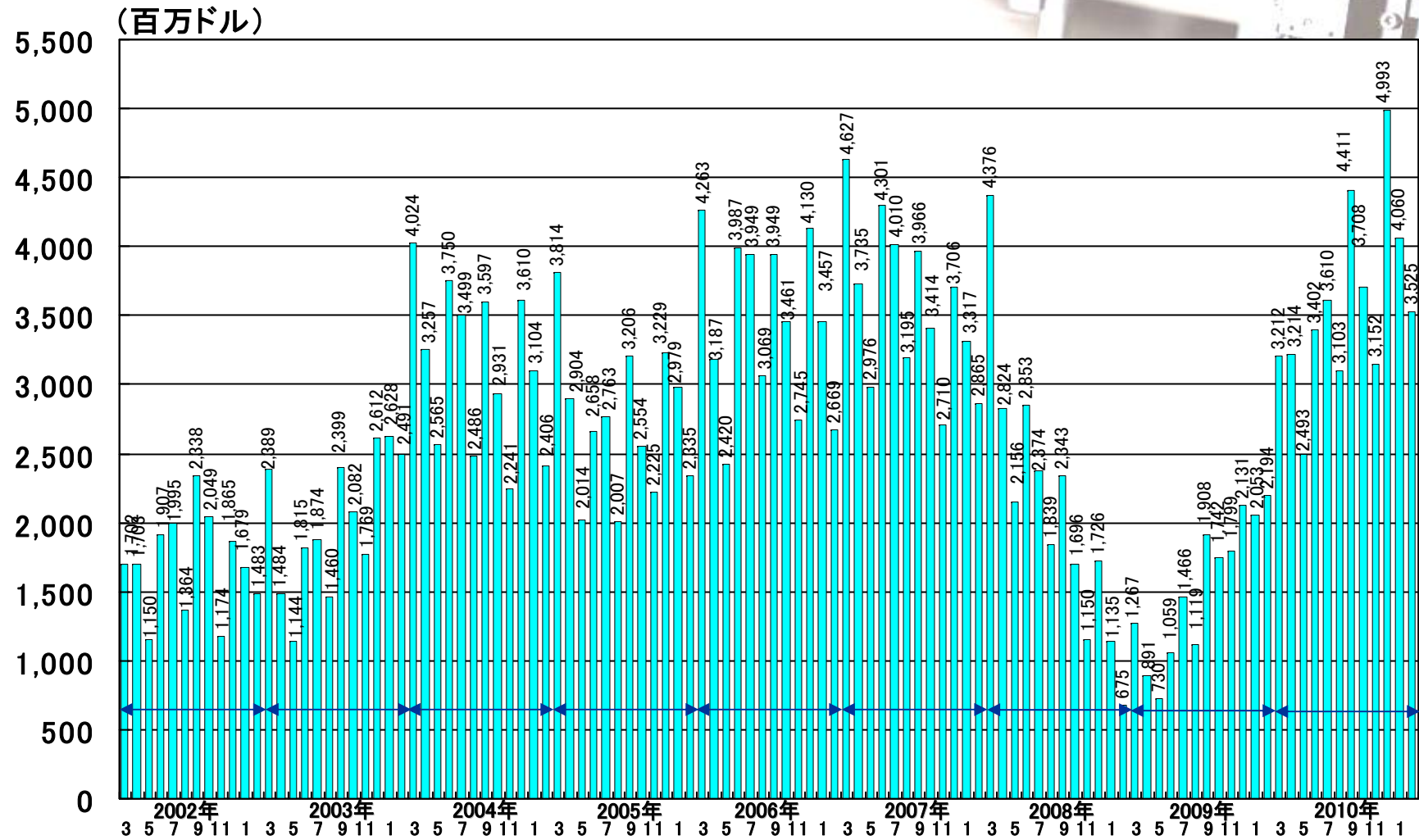
世界の地域別半導体市場規模



注:「A/P」はアジア・パシフィックの略
 (出所:2010年12月22日付 半導体産業新聞) (2010年11月 WSTS発表)

世界規模 半導体製造装置販売統計

(2011年2月末現在)



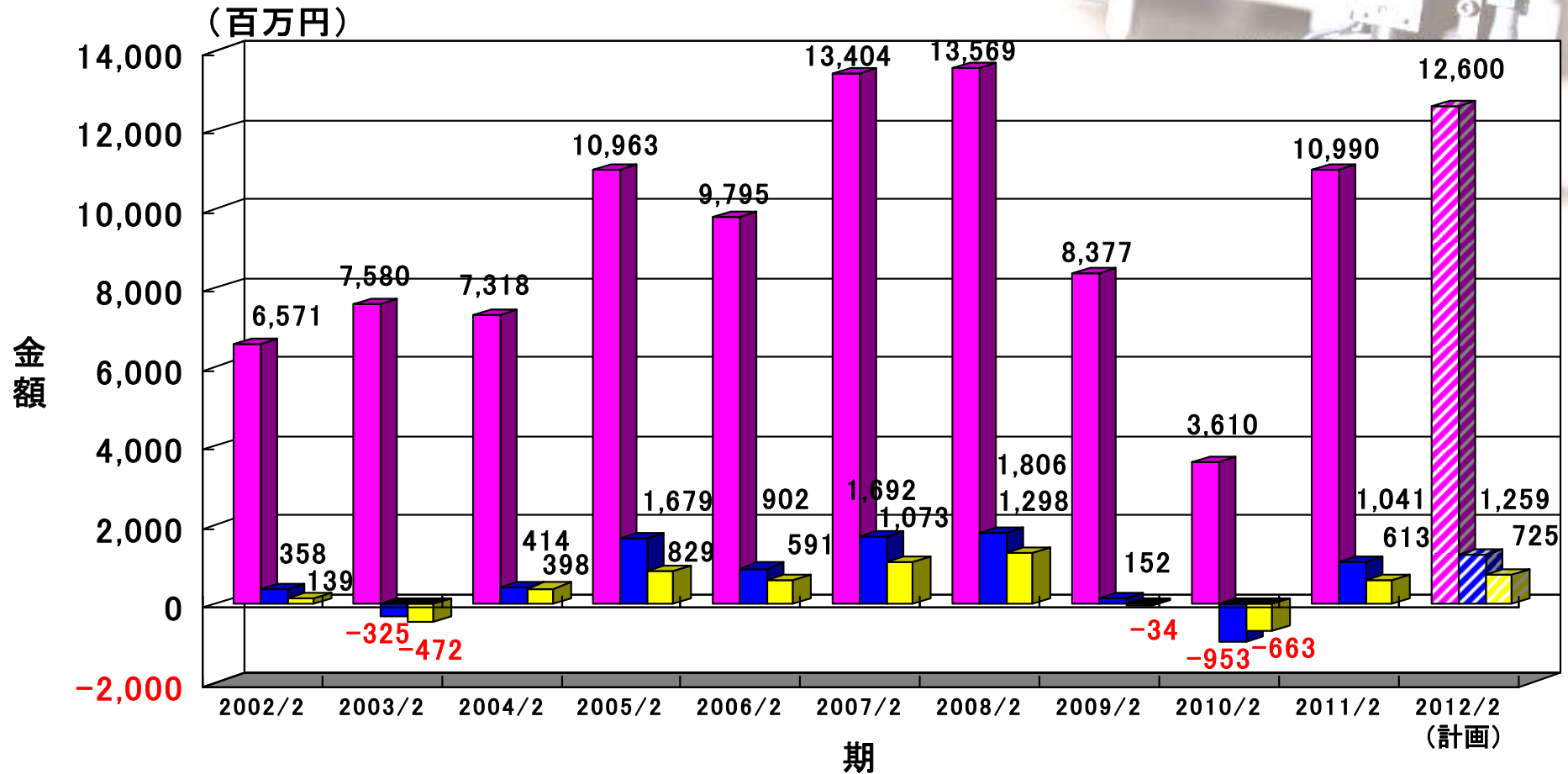
(出所：SEA J, SEMI, SEMIジャパン)

2012年2月期 連結通期業績予想

(百万円)

	2011年2月期 実績	2012年2月期 予想	増減率
売上高	10,990	12,600	14.6%
売上総利益	2,929	3,451	17.8%
販管費	1,769	2,122	19.9%
営業利益又は 営業損失(△)	1,159	1,328	14.6%
経常利益又は 経常損失(△)	1,041	1,259	20.9%
当期純利益又は 当期純損失(△)	613	725	18.2%

連結業績の推移と今期計画



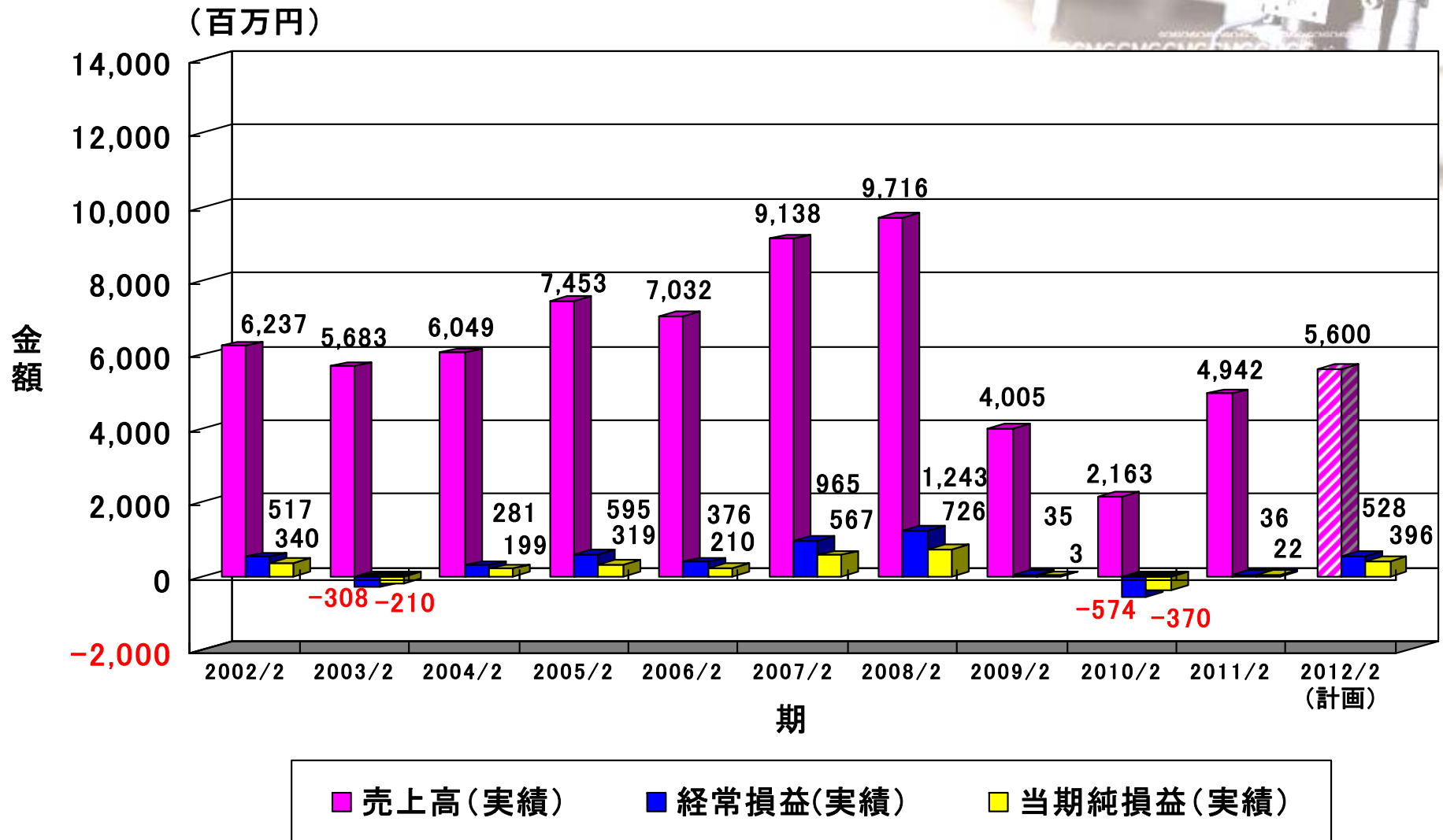
■ 売上高(実績)
 ■ 経常損益(実績)
 ■ 当期純損益(実績)

2012年2月期 個別通期業績予想

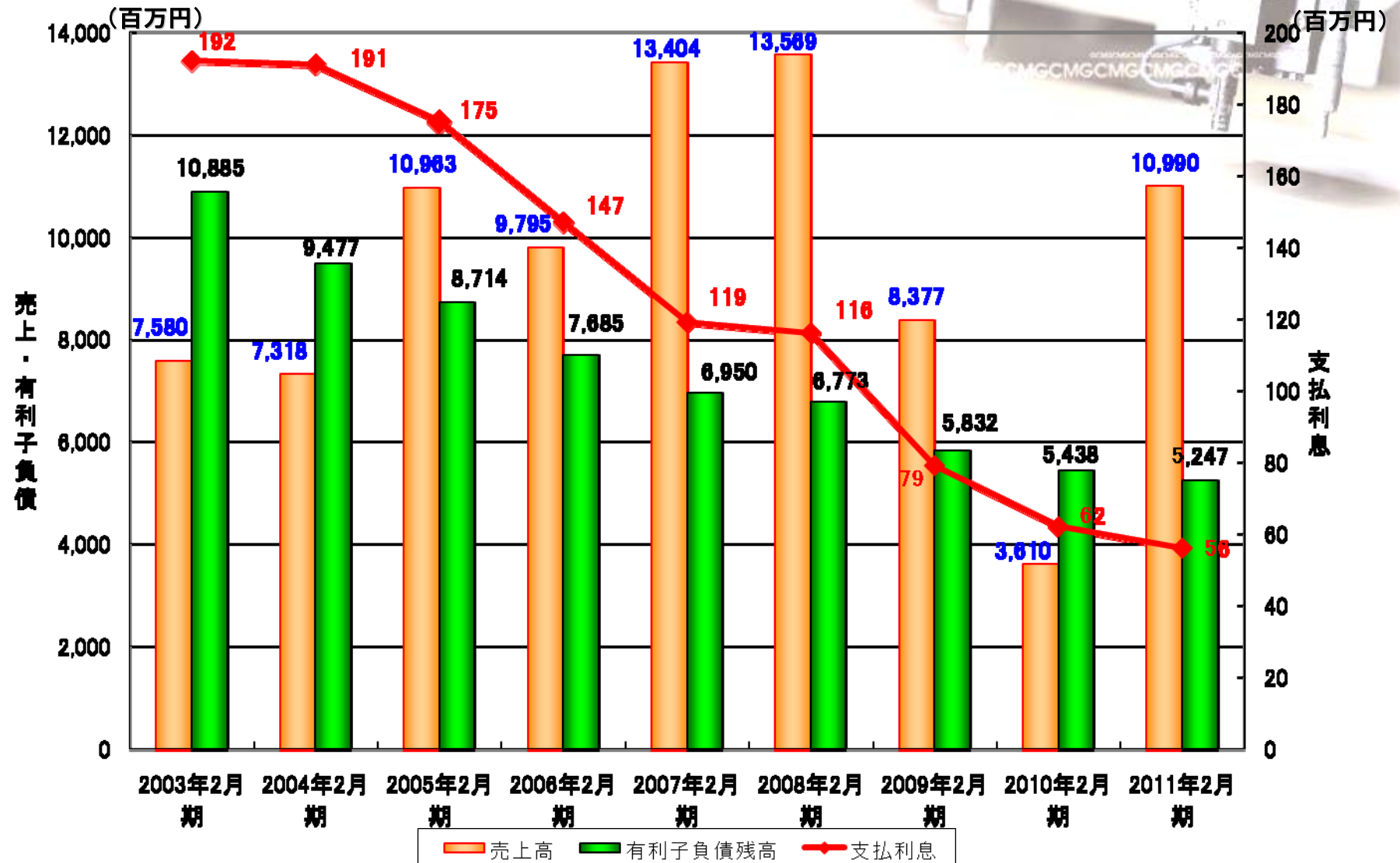
(百万円)

	2011年2月期 実績	2012年2月期 予想	増減率
売上高	4,942	5,600	13.3%
売上総利益	911	1,153	26.5%
販管費	882	1,076	22.0%
営業利益	29	77	162.9%
経常利益	36	528	1,336.4%
当期純利益	22	396	1,622.7%

個別業績の推移と今期計画



有利子負債残高の減少





ありがとうございました！

注意事項

この資料は、決算の業績に関する情報及び将来についての計画や戦略、業績に関する予想及び見通しの記述が含まれております。

これらの記述は、当社が現時点で把握可能な情報から判断した見通しや予測であり、その情報の正確性、完全性を保証したり約束したりするものではありません。

また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度等の変化により大きく見通しが変動する可能性があり、今後予告なしに変更されることがあります。